

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：国联证券

无锡豪帮高科股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

截止 2018 年 12 月 31 日，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润-24,670,137.70 元，未弥补亏损 24,670,137.70 元，公司实收股本 42,040,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

2018 年度公司净利润-26,486,032.40 元，且于 2018 年 12 月 31 日，豪帮高科公司的财务报表未分配利润-24,670,137.70 元。本年度继续亏损，主要原因：

1、2018 年度在 2017 年度研发费用 887 万元基础上新增研发费用 915 万元，主要原因是集成电路事业部的高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的项目研发所致。

2、受国际环境影响，占主营业务的线路板组品加工的电子产品事业部有部分客户外迁至东南亚国家，相应订单有所减少。

3、集成电路事业部和传感器事业部新增大批先进设备，用于硅

麦传感器、光耦合芯片等系列产品规模化生产，固定资产折旧增加。

三、采取措施

1、研发投入与业绩显现之间存在时间差属于正常现象，2019年度按照计划集成电路事业部的高灵敏高耐压光耦合芯片与智能功率模块的项目继续加大研发投入，经营业绩在2019年下期有所显现，预计未来会给公司利润带来可观贡献。

2、公司将继续开拓电子产品事业部新优质客户，与新客户合作的工业用线路板组品、通讯类线路板组品等多类型产品2019年进入量产阶段，电子产品事业部业绩会有所改善。集成电路事业部新导入的无锡晶源微电子有限公司、无锡矽瑞微电子股份有限公司等IC封装客户已进入量产阶段。传感器事业部在2019年继续开拓温湿度传感器、硅麦传感器、气体传感器、压力传感器等多种传感器客户，已经成功试产的传感器类新产品在2019年会进入规模化生产，使经营业绩会有大幅提升。

3、公司将合理缩减开支，降低运营成本，使得成本控制在更合理的范围。

四、备查文件目录

《无锡豪帮高科股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

《无锡豪帮高科股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2019年4月29日